

公 司 資 訊	公司名稱：精材科技股份有限公司			
	產業類別	半導體製造業	主要營業項目	晶圓封裝
	聯絡電話	03-4331818	傳真電話	03-4551551
	*公司地址	桃園市中壢區吉林路 23 號 9 樓		
	*成立時間	87 年 09 月份	*負責人	陳家湘
	*公司簡介 (請以公司營運介紹及願景簡述)	*福利制度 (除法定必要項目之員工福利)		
<p>精材科技股份有限公司成立於 1998 年，座落於台灣中壢工業區，是第一家將三維堆疊之晶圓層級封裝技術 (3D WLCSP) 商品化的公司。精材科技從事 CMOS 影像感測元件之晶圓層級封裝生產，並提供最佳的生產周期與極具競爭力的生產成本。</p> <p>由於具備高度的產品整合能力，三維堆疊之晶圓層級封裝技術可應用到各種不同的市場領域，如：消費電子、通訊、電腦、工業和汽車等。產品應用包括：影像感測器、光學感測器、電源管理積體電路、功率分離式元件、類比積體電路、混合信號積體電路、微機電系統感測器和整合式被動元件等。</p> <p>精材科技從事創新的三維堆疊之晶圓層級封裝製造服務，並以「誠信、創新、客戶導向」為公司的核心價值。精材科技是世界領先的先進封裝服務的供應商之一，期許成為最大的三維堆疊之晶圓層級封裝服務供應商。</p>		<p>■獎金：年終獎金保障 2 個月</p> <p>■點券：三節、勞動節、生日</p> <p>■訓練：完整訓練發展架構及多元學習管道</p> <p>■保險：勞保、健保、就保、勞工退休金提撥、員工及眷屬免費團保</p> <p>■補助：結婚禮金、生育祝賀金、住院慰問金、伙食費補助</p> <p>■娛樂：社團活動、家庭活動、體能競賽、歌唱比賽</p> <p>■其他：健身中心、員工舒壓按摩小站、健康檢查、特約商店</p>		

職缺內容說明 (*如超過兩項職缺，參閱填寫注意事項 3 之規定)

職務名稱 (需求 15 人)	測試工程技術員	職務名稱 (需求 15 人)	測試製造技術員
工作內容	<ol style="list-style-type: none"> 植針換針數量統計(PCR 工作) 工程師交辦事項及異常追蹤 日夜班輪值工作交接 Probe card 異常維修 	工作內容	<ol style="list-style-type: none"> 無塵室機台操作 系統操作
要求條件	需長期操作顯微鏡 細心、手操作穩定性高 具電腦基本操作 可負重(15-20kg)	要求條件	具備基本作業能力、刻苦耐勞 可負重(15~20kg)
工作時間	班別: 週 40 小時制 日班 07:30~19:40 夜班 19:30~07:40	工作時間	班別: 做二休二 日班 07:30~19:40 夜班 19:30~07:40

健行科技大學進修部 企業徵才登記表

(學 1110510)

	(每日工作 10 小時)		(每日工作 10 小時)
工作待遇	NT\$29,025~NT\$56,065	工作待遇	NT\$28,500~NT\$55,250
應徵資訊	應徵單位/部門	精材科技/人力資源處	
	聯絡人	吳小姐	
	聯絡電話	03-4331818#1310	
	電子郵件	Nicole_Wu2@xintec.com.tw	
		應徵方式/準備資料:	
		進修部公告核准章	
			

◎進修部公告之徵才資訊，如有意願應徵者，請依”應徵資訊”親洽辦理。